

Title (en)
PROCESS FOR COATING FINISH FILMS AND ENDLESS EDGES.

Title (de)
VERFAHREN ZUM BESCHICHTEN VON FINISH-FOLIEN UND ENDLOSKANTEN.

Title (fr)
PROCEDE DE REVETEMENT DE PELLICULES FINIES ET DE BORDS SANS FIN.

Publication
EP 0459991 A1 19911211 (DE)

Application
EP 90901812 A 19900126

Priority
DE 3905268 A 19890221

Abstract (en)
[origin: WO9010111A1] The invention concerns a process for coating finish films and endless edges in which an acid-hardening, aqueous coating composition based on an amino plastic resin/hydroxyl group-containing compound/self-crosslinking acrylate dispersion is applied and stoved. The coating composition used contains 5 to 20 wt. % of one or more fillers with a mean particle size of 0.015 to 10 μm , a maximum particle size less than or equal to 40 μm and a density less than or equal to 2.9 g/cm³. The invention also concerns the coating compositions used in the process and finish films and endless edges produced by the process, whose principle advantage is a negligible formaldehyde emission, particularly in conjunction with a low-formaldehyde chip board.

Abstract (fr)
Selon un procédé de revêtement de pellicules finies et de bords sans fin, on applique et on cuit une composition aqueuse de revêtement durcissable dans des acides, à base de résine aminoplastique, d'un composé contenant des groupes hydroxyles et d'une dispersion d'acrylate auto-réticulable. La composition de revêtement utilisée comprend entre 5 et 20 % en poids d'une ou plusieurs charges ayant des grains d'une grosseur moyenne comprise entre 0,015 et 10 μm , une grosseur maximale inférieure ou égale à 40 μm et une densité inférieure ou égale à 2,9 g/cm³. L'invention concerne également les compositions de revêtement utilisées pour mettre en oeuvre ce procédé et les pellicules finies et bords sans fin produits selon ce procédé. Ces pellicules et bords ont l'avantage d'avoir une émission de formaldéhyde extrêmement réduite, notamment en association avec des panneaux d'aggloméré pauvres en formaldéhyde.

IPC 1-7
D21H 19/56; **D21H 19/62**

IPC 8 full level
D21H 19/56 (2006.01); **D21H 19/62** (2006.01); **D21H 21/52** (2006.01)

CPC (source: EP US)
D21H 19/56 (2013.01 - EP US); **D21H 19/62** (2013.01 - EP US); **D21H 21/52** (2013.01 - EP US); **Y10T 428/24372** (2015.01 - EP US); **Y10T 428/24388** (2015.01 - EP US); **Y10T 428/24405** (2015.01 - EP US)

Citation (search report)
See references of WO 9010111A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0384506 A1 19900829; **EP 0384506 B1 19940720**; AT E108843 T1 19940815; AU 4957490 A 19900926; AU 633046 B2 19930121; BR 9007150 A 19920128; CA 2046873 A1 19900822; CA 2046873 C 19980630; DE 3905268 A1 19900823; DE 59006462 D1 19940825; DK 0384506 T3 19941114; EP 0459991 A1 19911211; ES 2060920 T3 19941201; US 5223323 A 19930629; WO 9010111 A1 19900907

DOCDB simple family (application)
EP 90200247 A 19900126; AT 90200247 T 19900126; AU 4957490 A 19900126; BR 9007150 A 19900126; CA 2046873 A 19900126; DE 3905268 A 19890221; DE 59006462 T 19900126; DK 90200247 T 19900126; EP 9000145 W 19900126; EP 90901812 A 19900126; ES 90200247 T 19900126; US 74328890 A 19900126